

# NORDCAD SEMINAR

 **ONSDAG 26/3**

	Spor 1	Spor 2	Spor 3	Spor 4	Spor 5
09.00	Morgenmad				
10.00	Velkomst				
12.00	Frokost				
13.00		<b>Fremtiden for elektronik - Del 1</b> Komponentdesign med integreret analyse og PCB-forplacering, analyse og gennemgang	<b>PLM m. Highstage</b> Sådan arbejder du med specifikationer, revisioner og godkendelser af komponenter, elektronik og færdige produkter	<b>AWR</b> Optimer dit antenne- og RF-forstærkerdesign	<b>CAM350</b> Spar tid og undgå fejl i produktionen
13.45	Kort pause				
14.00	<b>Design Review</b> Designgennemgang for bedre resultater	<b>Fremtiden for elektronik - Del 2</b> Komponentdesign med integreret analyse og PCB-forplacering, analyse og gennemgang	<b>Bæredygtighed</b> Udforskning af produkters bæredygtighed - fra koncept til færdigt produkt	<b>PLM m. Highstage</b> Sådan arbejder du med specifikationer, revisioner og godkendelser af komponenter, elektronik og færdige produkter	<b>PCB Dokumentation</b> Effektiv PCB-dokumentation med Blueprint
14.45	Pause				
15.15	<b>PCB Roadmap</b> Navigering i PCB designprocessen - din roadmap fra start til slut	<b>SI/PI</b> Få godt styr på SI/PI - en ligetil guide for alle	<b>Bæredygtighed</b> Hvad er vigtigt i designet af mere bæredygtig elektronik?	<b>Bæredygtighed</b> Udforskning af produkters bæredygtighed - fra koncept til færdigt produkt	
16.00	Seminar dag slutter				
17.30	Aftenunderholdning og middag				

\* Ændringer i programmet kan opstå.

	Spor 1	Spor 2	Spor 3	Spor 4	Spor 5
08.00	Morgenmad				
10.00	<b>PCB</b> Seneste udviklinger inden for constraints og highspeed routing	<b>CFD</b> Emne på vej	<b>OrCAD X</b> Nyeste funktioner i PSpice (arbejde med lydfile, temperaturanalyse, målinger, nye kilder og bilindustrikilder, adfærdsmæssige dioder, forbedret temperatursupport til dioder m.m.)	<b>SI/PI</b> Modellering for EM-ekstraktion - forståelse af indflydelsen fra stackup og materialevalg	<b>Downstream</b> Emne på vej
10.15	Pause				
10.45	<b>PCB</b> Udnyttelse af 3D og 3D-constraints (ECAD-MCAD integration og grænseflade)	<b>CFD</b> Emne på vej	<b>OrCAD X</b> Oprettelse af et cloud-bibliotek, deling af dele med teammedlemmer, håndtering af designrevisioner, datastyring af komponenter og håndtering af forsyningskædeproblemer	<b>SI/PI</b> Måling vs. simulation - et virkelighedstjek: Hvordan EM-solverindstillinger påvirker overensstemmelse med målinger	<b>Downstream</b> Emne på vej
12:00	Frokost				
13.00	<b>PCB</b> Design for Manufacturing	<b>CFD</b> Emne på vej	<b>Nyeste PCB-design - Del 1</b> Nyeste teknologi, herunder brugervenlighed, funktionsoversigt, nem definition af constraints i et panel, skematisk gruppering af komponenter, optimering af brugeroplevelsen, footprint-genering, 2D/3D, ad hoc teamdesign og PCB-dokumentation	<b>SI/PI</b> Kom godt i gang med SI/PI for el- og PCB-ingeniører	<b>Downstream</b> Emne på vej
14.15	Pause				

14.45	<b>PCB</b> Tips og tricks	<b>CFD</b> Emne på vej	<b>Nyeste PCB-design - Del 2</b> Nyeste teknologi, herunder brugervenlighed, funktionsoversigt, nem definition af constraints i et panel, skematisk gruppering af komponenter, optimering af brugeroplevelsen, footprint-genering, 2D/3D, ad hoc teamdesign og PCB- dokumentation	<b>SI/PI</b> Simulation med topologier og kørsel af constraints gennem topologi-udforskning	<b>Downstream</b> Emne på vej
16.00	Seminardag slutter				

\* Ændringer i programmet kan opstå.